

# Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik



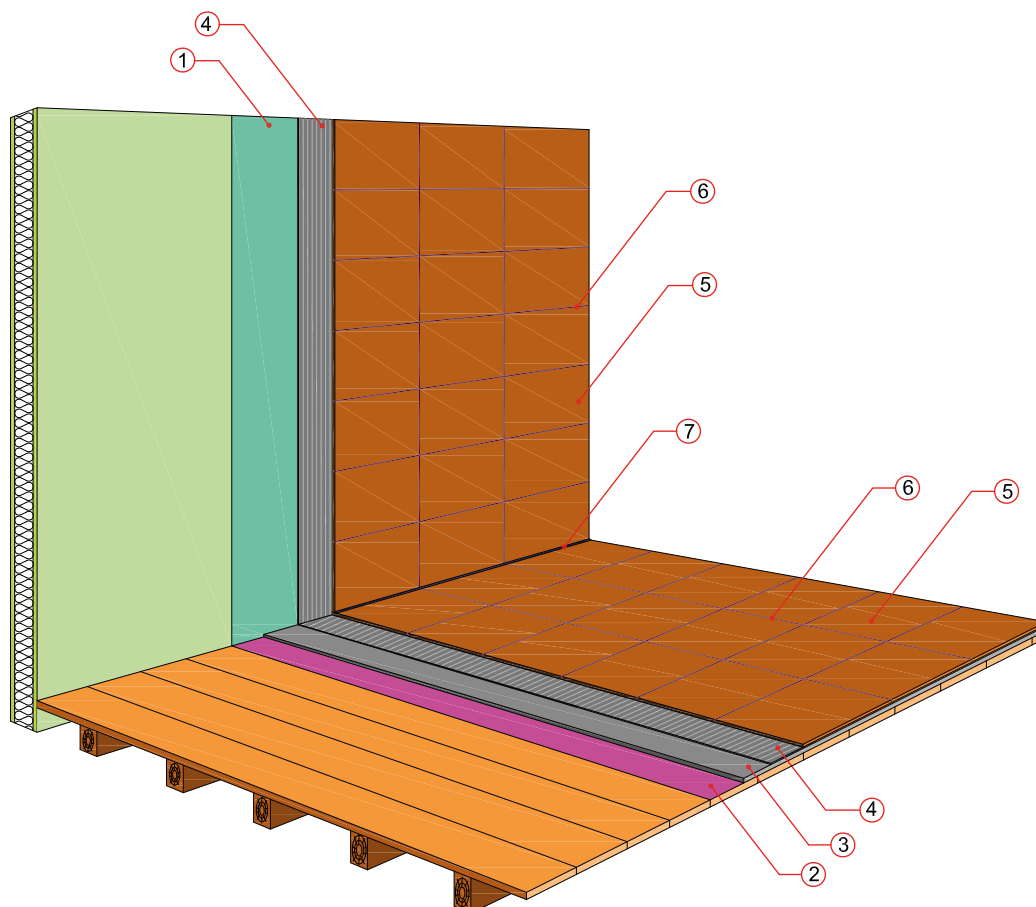
A brand of

**BASF**

We create chemistry

## 2. Płytki na podłożu odkształcalnym

Wariant 1: podłóże ściany: płyta g-k, podłóże posadzki: deska drewniana

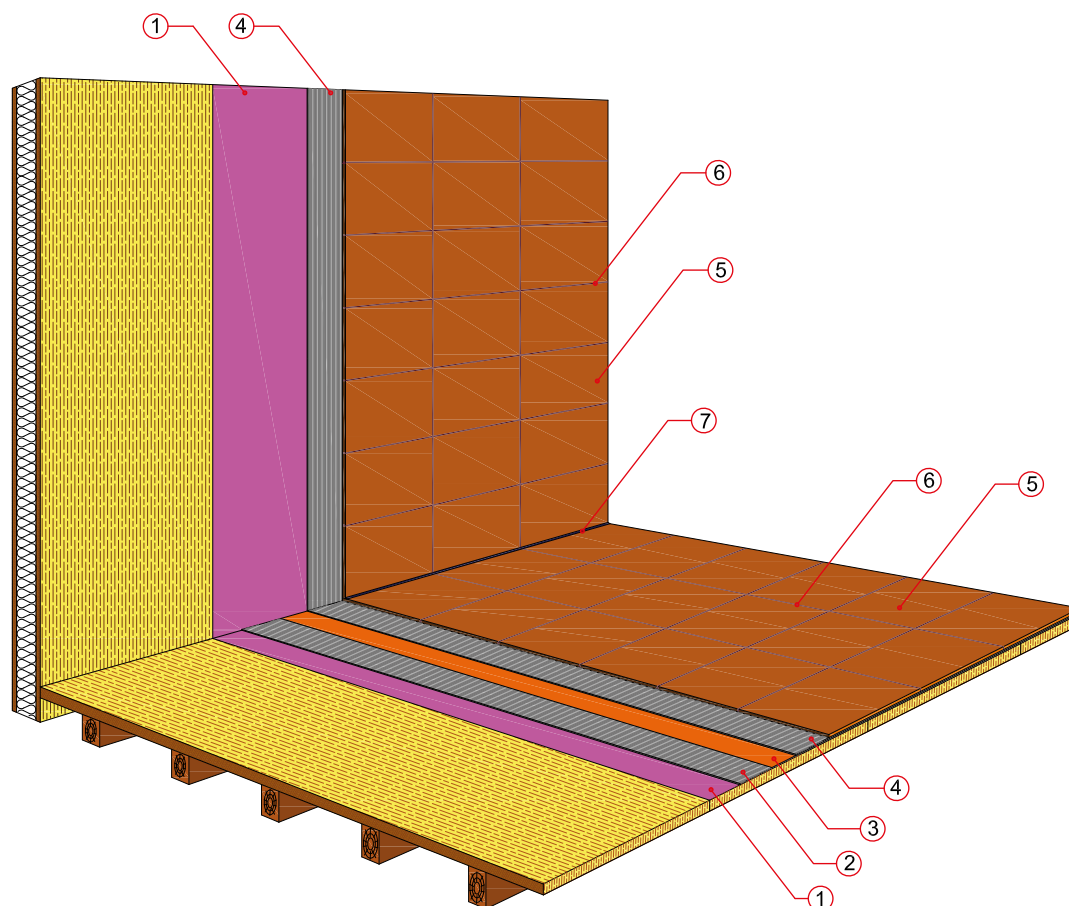


Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt na ścianę	PCI Gisogrund	Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
2	Grunt na posadzkę	PCI Gisogrund 404	Grunt dyspersyjny do podłoży niechłonnych i drewnianych
		PCI Wadian	Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
3	Zaprawa wyrównująca posadzkę	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	Cementowa masa poziomująca z rozproszonym włóknem
		PCI Pericem 515 + PCI Armiermatte GFM	Cementowa masa poziomująca + siatka z włókna szklanego
4	Klej do płytek	PCI Nanolight	Uniwersalny elastyczny klej cementowy
5	Płytki		
6	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
7	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

### Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach odkształcalnych występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów o różnej funkcji: głównie mieszkalnych i biurowych, suchych i mokrych, nowo wznoszonych i remontowanych. Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pomieszczeń suchych. W przypadku mokrych należy uwzględnić dodatkowo wytyczne innych odpowiednich rozdziałów niniejszej broszury. Podstawowe obciążenia to ruch pieszki oraz ciężar mebli. Brak naprężeń związanych ze znacznymi zmianami temperatur, a do obciążeń chemicznych zaliczyć można jedynie środki myjące, nie stanowiące zagrożenia dla fug o ile stosowane są zgodnie ze swymi instrukcjami użycia. W dużych pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.

## Wariant 2: podłoże ściany i posadzki: płyta OSB



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt	PCI Gisogrund 404	Grunt dyspersyjny do podłoża niechłonnych i drewnianych
		PCI Wadian	Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
2	Klej do płytek	PCI Nanolight	Uniwersalny elastyczny klej cementowy
3	Arkusz oddylatowujący	PCI Pecilastic U	Arkusz uszczelniający i oddylatowujący
4	Klej do płytek	PCI Nanolight	Uniwersalny elastyczny klej cementowy
5	Płytki		
6	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
7	Uszczelniaacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniaacz silikonowy

## Podłoże

Wśród podłoży odkształcalnych wymienić należy zwłaszcza: płyty z materiałów drewnopochodnych (głównie OSB), podłogowe deski drewniane i płyty kartonowo-gipsowe. Mogą one występować na ścianach lub na posadzkach. Do odkształcalnych kwalifikuje się także tzw. „podłoża mieszane”. Ma to miejsce głównie w remontach, gdy np. na jednej powierzchni posadzki występują: jastrych cementowy, stare okładziny ceramiczne i deski drewniane. Zasadniczo przyjmuje się, iż zastane podłoża winny być nośne, czyste i równe, tzn. wymagające jedynie zastosowania systemu, przejmującego ich nadmierne naprężenia w płaszczyźnie, które to naprężenia mogłyby doprowadzić do uszkodzeń okładziny płytkowej, np. do pękania fug czy odspojen płytek. W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię posadzki. Wszystkie dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie ceramicznej. O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.

## Wykonawstwo

### A. INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY

#### A1. Płyty kartonowo-gipsowe

Płyty kartonowo-gipsowe muszą być przymocowane do podłoża (np. stelażu) w sposób gwarantujący ich wystarczającą sztywność i nośność dla bezpośredniego przyklejenia okładziny płytkowej. Należy je zagruntować środkiem **PCI Gisogrund** bez rozcieńczania go wodą.

#### A2. Płyty OSB na ścianach

Płyty OSB na ścianach winny posiadać grubość min. 19 mm i być przymocowane do podłoża łącznikami mechanicznymi, rozmieszczonymi nie rzadziej, niż co 40 cm. Ich styki należy połączyć w sposób trwały (np. klejone „na pióro i wpust”). Podłoże z płyt OSB musi zapewnić wystarczającą sztywność do bezpośredniego przyklejenia okładziny płytkowej. Płyty OSB, zabezpieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody zaleca się gruntować nierozcieńczonym środkiem **PCI Gisogrund 404**.

#### A3. Płyty OSB na posadzkach

Płyty OSB na posadzkach winny posiadać grubość min. 25 mm i być przymocowane do podłoża łącznikami mechanicznymi, rozmieszczonymi nie rzadziej, niż co 40 cm. Ich styki należy połączyć w sposób trwały (np. klejone „na pióro i wpust”). Płyty OSB, zabezpieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody, zaleca się gruntować nierozcieńczonym środkiem **PCI Gisogrund 404**. Generalnie same płyty OSB winny posiadać wystarczającą sztywność i nośność dla ułożenia na nich okładziny płytkowej. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa można przykleić na płytach OSB elastycznym klejem cementowym **PCI Nanolight** arkusz oddylatowujący **PCI Pecilastic U**. Arkusz ten redukuje dodatkowo o 8 dB hałas kroków lub uderzeń oraz może stanowić hydroizolację.

#### A4. Deski podłogowe

Deski podłogowe winny być odpowiednio sztywne i nośne oraz mieć czystą powierzchnię. Łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć, trwale przylegające mogą pozostać. Pozostawione powłoki należy zagruntować nierozcieńczonym środkiem **PCI Gisogrund 404**. Niezabezpieczone drewno zaleca się gruntować 2x środkiem **PCI Wadian**, działającym także paroizolacyjnie. Następnie można alternatywnie położyć jedną z niżej wymienionych warstw:

- a) cementowa masa poziomująca z rozproszonym włóknem **PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34**;
- b) cementowa masa poziomująca **PCI Pericem 515** z wbudowaną siatką z włókna szklanego **PCI Armiermatte GFM**;
- c) arkusz oddylatowujący **PCI Pecilastic U**, przyklejony na elastycznym cementowym kleju **PCI Nanolight**.

Wylewki (wariant a). i b).) pozwalają dodatkowo na wyrównanie podłoża.

#### A5. Posadzki z podłożami mieszanymi

Wszystkie zastane rodzaje podłoża muszą być powierzchniowo czyste i zapewniać przyszłej okładzinie płytkowej wymaganą sztywność oraz nośność. Dla ich ujednolicenia, uniknięcia zarysowań okładziny w miejscu styków różnych rodzajów podłoża oraz dla ewentualnego wyrównania, można położyć na nich zgodnie z potrzebami jedną z trzech warstw, wymienionych w ppkt. A4. Upřednie gruntowanie należy dostosować do danego rodzaju podłoża, czyli:

- podłoża mineralne - grunt **PCI Gisogrund** lub **PCI Gisogrund 404** w odpowiednim rozcieńczeniu wodą;
- podłoża niechłonne - grunt **PCI Gisogrund 404** bez rozcieńczania wodą;
- podłoża z niezabezpieczonego drewna - 2x grunt **PCI Wadian**.

### B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny płytkowej zaleca się użycie uniwersalnego elastycznego kleju cementowego (C2TE S1 wg PN-EN 12004) - **PCI Nanolight**.

### C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium**.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**.

## Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.